

证券代码：874810

证券简称：中欣晶圆

主办券商：财通证券

杭州中欣晶圆半导体股份有限公司

关于 2026 年度申请金融机构授信额度暨关联担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

杭州中欣晶圆半导体股份有限公司（以下简称“公司”）根据发展计划，为满足公司日常生产经营的资金需求，2026 年度公司及子公司（含全资及控股子公司，下同）拟向金融机构申请不超过人民币 70 亿元（含本数）的授信额度（包括项目贷款授信、融资租赁及综合授信等，含授信到期续授信，最终具体授信额度以各金融机构实际审批为准），有效期自公司 2025 年年度股东会批准之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。授信用途包括但不限于流动资金贷款、国内（际）信用证、保函、银行承兑汇票、票据贴现、保理、贸易融资、供应链融资、票据池、融资租赁、项目贷款及固定资产贷款等。授信有效期内，实际授信额度可在授权范围内循环使用。同时，公司拟为子公司申请银行等金融机构授信提供总额度不超过人民币 35 亿元（含本数）的连带责任保证担保，有效期自 2025 年年度股东会批准之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

在前述额度内，提请董事会授权公司法定代表人或其授权代表在上述授信额度内，根据公司及子公司实际经营情况及资金需求情况具体办理相关银行综合授信事宜及签署相关的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资等有关的申请书、合同、协议、凭证等文件）。

（二）审议和表决情况

2026年3月22日召开第三届董事会审计委员会第十次会议，审议通过《关于2026年度申请金融机构授信额度暨关联担保的议案》。表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

2026年3月23日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于2026年度申请金融机构授信额度暨关联担保的议案》。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避4票。

二、被担保人基本情况

（一）预计对控股子公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形

预计为子公司申请银行等金融机构授信提供总额度不超过人民币35亿元（含本数）的连带责任保证担保，有效期自2025年度股东会批准之日起至2026年年度股东会召开之日止，具体的担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的合同（协议）为准。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

申请授信额度及安排相关担保事项是为了实现公司生产经营及后续发展建设的正常所需，可有效缓解公司未来运营资金压力，推动公司业务良性发展。

（二）预计担保事项的利益与风险

公司本次相关担保事项安排有利于保证其业务发展和日常经营资金需求，本次预计担保涉及的被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其经营管理，财务等方面具有控制权，违约风险和财务风险在公司可控范围内。

（三）对公司的影响

申请授信额度及安排相关担保事项不会对公司财务状况和经营成果产生不利的影响，有利于公司持续、稳定、健康的发展，符合公司及中小股东的利益，符合公司长远发展目标。

四、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	350,000.00	72.86%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	109,826.20	22.86%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额		
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

注：以上审计净资产为经审计后的归属于母公司净资产

五、备查文件

- 1、《杭州中欣晶圆半导体股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
- 2、《杭州中欣晶圆半导体股份有限公司第三届董事会审计委员会第十次会议决议》
- 3、《杭州中欣晶圆半导体股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

杭州中欣晶圆半导体股份有限公司
董事会

2026年3月24日